

TO-220FP

TO-220FP（フルパック）はTO-220のフルパックバージョンであり、Cuクリップ構造によってより優れた放熱効率を備え、旧来のTO-220 NISパッケージと比較して2.8 mmパッケージ取付高さが低くなっています。

Applications

TO-220FPは中電圧から高電圧MOSFETおよびIGBTに適しており、次の用途に使用されます。

- ▶ 電源切替え
- ▶ ACアダプター
- ▶ モータードライバ
- ▶ フラットパネルディスプレイ

Reliability Qualification

Amkorのデバイスは実績のある信頼性の高い部材で製造されています。

- ▶ 温度サイクル：-55~150°C, 500 cycles
- ▶ 高温バイアス：150°C for 1000 hrs
- ▶ はんだディップ：260°C/10s

Test Services

Amkorはすべてのパワーディスクリート製品においてフルターンキーを提案いたします。MOSFET、バイポーラトランジスター、IGBT、ダイオードおよびレギュレータIC/インテリジェントパワーデバイスを含む様々なパワーデバイスのテストに対応します。

- ▶ Amkorのパワーディスクリートテスト
 - ▷ DC試験
 - ▷ AC試験（スイッチング試験、容量試験、Rg試験等）
 - ▷ L負荷試験（UIS）
 - ▷ 熱抵抗（ ΔVDS 、 ΔmV など）
- ▶ プログラム作成/コンバージョン
- ▶ 不良解析
- ▶ テスト/ハンドリング技術
- ▶ マーキング、外観検査、テープ&リール一体機

FEATURES

- ▶ より優れた放熱効率のためのCuクリップインターコネク
- ▶ 標準のTO-220NISと比較して、パッケージ取付高さ2.8 mm減
- ▶ テストとパッキングサービスを備えたターンキー
- ▶ 環境に優しい材料：Pbフリーめっき、ハロゲンフリーモールド樹脂

NEW DEVELOPMENTS

- ▶ より大型/より高密度のリードフレームストリップ
- ▶ 環境に配慮したPbフリーはんだペースト

PROCESS HIGHLIGHTS

- ▶ めっき加工なしのベアCuリードフレーム
- ▶ インターコネク：より優れた電気性能と熱性能を追求したCuクリップ
- ▶ めっき：100%無光沢Sn
- ▶ マーキング：ペンタイプレーザー



TO-220FP

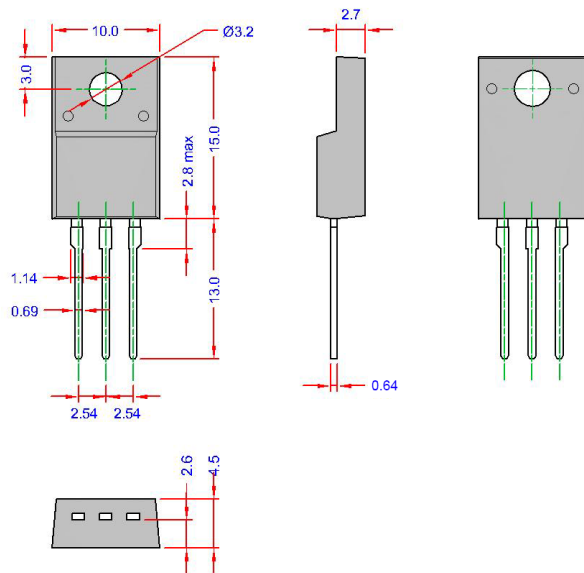
Standard Materials

- ▶ リードフレーム：ベアCu
- ▶ ダイアタッチ：はんだペースト
- ▶ インターコネクト：デュアルCuクリップ
- ▶ モールド樹脂：ハロゲン/ハロゲンフリー

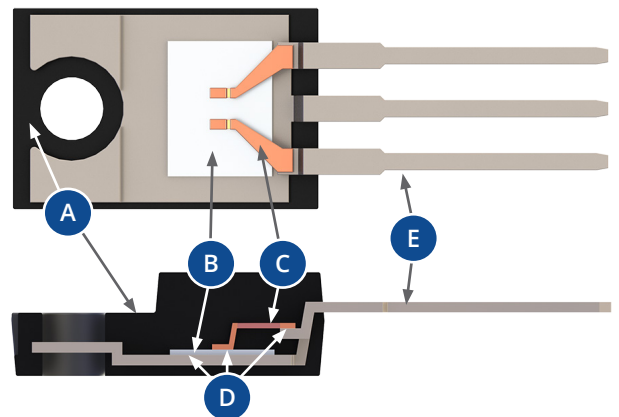
Shipping

- ▶ チューブ/簡易梱包
 - ▷ チューブ = 1500 pcsまたは2500 pcs/箱
 - ▷ 簡易梱包 = 500 pcs/箱
- ▶ バーコードラベル
- ▶ ドロップシップ

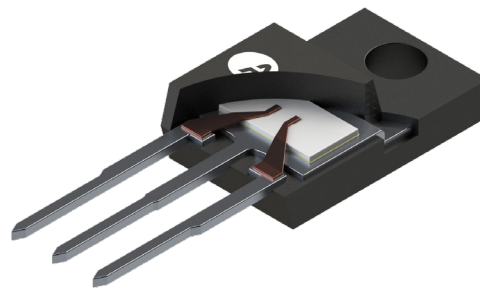
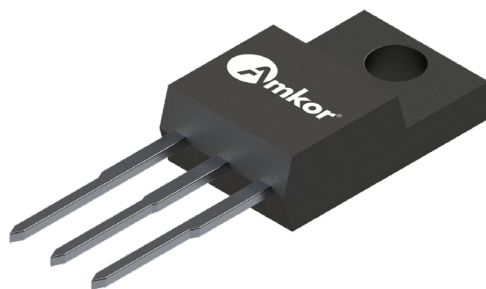
Package Outline Drawing



Cross Section



- A Mold compound
- B Die
- C Cu clip
- D Solder paste
- E Leadframe



詳細についてはamkor.comにアクセスしていただくか、またはsales@amkor.com までメールをお送りください。

本文中の情報に関して、Amkorはそれが正確であることまたは係る情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、如何なる保証も致しません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じた如何なる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によって如何なる特許またはその他のライセンスも許諾致しません。本文書は、如何なる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、如何なる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標はそれぞれの会社の財産です。© 2020 Amkor Technology, Incorporated. All Rights Reserved. DS610D-JP Rev Date: 01/20

